

160 毫米/6 英寸切割机

从样品试切到批量生产，  
覆盖每一种需求

完全灵活，完全控制

## MICROACE 66



### 广泛的应用领域

从最新设计的 wafer 到陶瓷元件，以及其中包含的一切材料；切割深度达到 13mm，MICROACE66 满足了所有的切割要求

### 极致的生产效率

各种材料的切割需求？

更短时间的切割需求？

各种尺寸的切割需求？

便捷的装载模式，快速的工具更换，高效的程序录入使得各种各样的切割工作也不会降低生产效率。

ENGINEERED TODAY FOR THE TECHNOLOGY OF TOMORROW

Room 105, NW-20, Nanopolis Suzhou, 99 Jinji Lake Avenue, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China

Tel: +(86)512-8518 7989 Fax: +(86)512-8518 7990 [www.loadpoint.cn](http://www.loadpoint.cn)

# MICROACE 66

MICROACE 66 是一个微切割系统，它涵盖了晶圆和基板划片的所有方面。在 LOADPOINT 的“NanoControl”系统的控制下，MICROACE 66 有极大的灵活性去完成样品试切、小批量试切和全自动控制的大批量生产任务。

加工材料包括: 陶瓷、FR3/FR4、GaAs、锗、玻璃、InP、LED、铌钽酸锂、陶瓷和 QFN、压电陶瓷、PZT、石英、蓝宝石和硅等。

## 标准配置

### LOADPOINT 空气主轴

- 非常低的振动提高了切割质量，减少了崩边
- 1.2kW 直流无刷驱动能力在从 5000 到 60000 整个速度范围内提供全功率配置
- 高功率, 2.4kw 60,000 rev/min
- 高分辨率直接驱动θ轴旋转平台

### 视觉对齐系统

手动和自动对齐方式:

- 单目视觉对齐系统与模式识别系统
- 模式识别系统 (PRS)
- 两点对齐与可编程的外切调整手册
- 手动和自动(可选)刀痕检测和崩边测量
- 17 英寸/430mm 监视器，用于对齐、数据输入和机器监视
- 连续实时显示 X, Y, Z 和θ的坐标
- 可实现图像 Z 轴自动焦点设置，并带有切割深度的调整选项

## 工具

- 配备适用于直径 50-76.2 毫米刀片的标准法兰
- 刀片具有三个方向的冷却水冲洗: 刀片主冷却水喷嘴、刀片两侧的冷却水及晶圆清洗喷嘴
- 基于 Z 轴基准的加速度设置，非卡盘式的测高系统

### Z 轴高度传感

非卡盘接触式测高系统，即使使用不导电的刀片，也可正常切割，提供了更广泛的刀片直径和供应商的选择。

### 工件固定

陶瓷真空盘标准配件包含了圆形工作盘和方框形工作盘（工作区域为圆形）。LOADPOINT 可以提供标准的和各种定制的陶瓷真空盘；定制陶瓷盘包括客户定义真空通道、机械装夹架构等满足客户需求的功能。满足客户的要求。



苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 20 栋 105 室

Tel: +(86)512-8518 7989 Fax: +(86)512-8518 7990 www.loadpoint.cn

## LOADPOINT 专业知识

每一个 LOADPOINT 系统都配备一个 LOADPOINT 空气主轴。该空气主轴在过去的 40 多年里不断的发展革新。我们的客户相信 LOADPOINT 可以帮助他们开发一流的产品。我们已经帮助我们的客户开发了超声波扫描仪、喷墨打印机、声表面波滤波器、MEMS 设备和一整套硅基产品的解决方案。

### 微加工解决方案:

半导体	光学镜片
电子工业	医学的
铁电体	太阳能
光电子	声纳



## 操作规范

工作应用	直径 160mm
刀片	直径 50 - 76.2mm
X, Y, Z 驱动	交流无刷
Y 轴步进范围	0.001 - 160mm
Y 轴步进精度	0.0001mm
X 轴行程	160mm
切割速度	0.01 - 500mm/s
Z 轴范围	使用 76.2mm 的刀片时，切割深度可达 13mm
Z 轴精度	0.0001mm
Z 轴速度	75mm per sec
θ 轴驱动	带旋转编码器的直接驱动转矩马达
θ 轴行程	360° (持续转动)
θ 轴速度	150° per sec
θ 轴精度	0.0005°
机器尺寸	W 570mm, D 1215mm, H 1555mm

可选连接可用于外部真空供应和切割区域提取。未经通知更改的初步规范